



【東京・有明】ドイツの半導体製造装置メーカーでのプロセス・サービスエンジニア

Job Information

Hiring Company

[Hesse Mechatronics](#)

Job ID

1470313

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards, Koto-ku

Salary

6 million yen ~ 10 million yen

Work Hours

8:45~17:30 (休憩1時間)

Holidays

土日、祝日

Refreshed

August 1st, 2024 03:00

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 6 years

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Basic

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

★アピールポイント

- 海外出張あり

仕事内容

- 半導体製造装置(ワイヤーボンダー、主にウェッジボンダー)の納入、立上げ、検収立ち合い(国内、日本顧客の海外工場の場合もあり)
- 客先または社内での装置のオペレーション、メンテナンス、プロセストレーニングの実施
- ワイヤーボンディング、超音波溶接のプロセス開発
- 装置不具合のトラブルシューティング
- 搬送やワーク固定方法など要求仕様確認と提案

- 取扱説明書、手順書、仕様書などの英語-日本語間の翻訳
- 展示会での訪問客へ装置やプロセスの説明
- ワークライフバランスに配慮した業務遂行が可能

募集背景：主にEV関連向けに需要拡大のため

Required Skills

【必須 (MUST)】

- 製造機械の設計または技術サポートの経験、または後工程半導体製造装置の使用経験5年以上。
- 半導体・電子部品製造工場の現場での作業に前向きな方
- 上記業務に強い興味をお持ちの方
- 英語読み書き、会話、初級レベル

【歓迎 (WANT)】

- ウェッジボンダ、ボールボンダの知識、経験
- 半導体業界、自動車業界の経験
- セールスエンジニアとしての経験
- 英語読み書き、会話、日常会話・ビジネスレベル

【その他】

- 明朗快活な方
- 顧客目線で考えることができる方
- 好奇心、向上心がある方

雇用形態：期間の定めなし
試用期間なし

年収：600万円～1,000万円

勤務地：東京都江東区

勤務時間：8:45～17:30（休憩1時間）
残業あり（月平均20時間）

休日休暇：土日、祝日

社会保険：健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険

Company Description